

関東学院大学 三次元電子回路実装技術研究所 第二回公開研究会開催のご案内

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

さて、関東学院大学 三次元電子回路実装技術研究所 第二回公開研究会を下記の通り開催いたしますのでご案内申し上げます。

敬具

記

日時 : 平成30年11月26日(月) 13:00~17:15

場所 : 関東学院大学 関内メディアセンター

〒231-0011 横浜市中区太田町2-23 YMBC 8F TEL: 045-650-1131

テーマ「IoT 社会を創る日本の技術」

13:00~14:00

「MID-Kongress bringt auch 2018年9月にドイツで開催されたMID国際会議報告」

研究所長(関東学院大学教授) 小岩 一郎

14:00~15:00

「熱可塑性ポリイミドを使用した立体両面配線基板の開発」

株式会社メイコー

道脇 茂

----- 15:00~15:15 休憩 -----

15:15~16:15

「MID (Molded Interconnect Device) 用銅ペースト」

日立化成株式会社

米倉 元気

16:15~17:15

「電子回路を樹脂成型品に埋設する技術」

オムロン株式会社

川井 若浩

参加費 : 所員、幹事、公的機関(経産省・NEDO) : 無料

JIEP 会員 : 5千円

協賛団体会員 : 5千円

シニア会員 : 2千円

学生(資料代) : 1千円

一般 : 1万円

定員 : 100名 (定員になり次第締め切り)

申し込み先・問い合わせ先 :

下記の必要事項を明記の上、メールまたはファックスにてお申し込みください。

(1) お名前 (2) 所属(会社名・団体名等) (3) 会員種別(JEIP 会員、協賛団体会員、シニア会員、一般、学生) (4) 電子メールアドレス (5) 住所

◆申込方法、問い合わせ先

参加申込先 : 〒236-8501 神奈川県横浜市金沢区六浦東1-50-1

関東学院大学 理工学部 化学学系 佐々木康 e-mail : 3djisso@kanto-gakuin.ac.jp

以上